

杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A47 版)

Table with 5 columns: 行业类别, 上市公司代码, 上市代码, 总资产(万元), 营业收入(万元), 归母净利润(万元)

[注]: 上述数据来源于各公司 2019 年年度报告。上述公司的研发水平如下:

Table with 5 columns: 行业类别, 上市公司代码, 上市代码, 研发投入, 营业收入, 研发人员占比

[注]: 上述资料来源于各公司 2019 年年度报告

(六) 发行人在行业中的竞争地位

1. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
发行人控股子公司浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产...

2. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

3. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

4. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

5. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

6. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

7. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

8. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

9. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

10. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

11. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

12. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

13. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

14. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

15. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

16. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

17. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

18. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

19. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

20. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

21. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

22. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

23. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

24. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

25. 发行人在半导体硅片行业中的竞争地位
经过多年发展, 发行人在完整的硅片-硅片加工-器件生产产业链方面具有较强竞争优势...

取得产权证书, 出租人有权出租该等房产。

除上述第 1 至 9 项租赁房产外, 其余 18 处租赁房产均已完成备案, 合计备案租赁面积 19,240.91 平方米...

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司主要机器设备情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 数量, 原值(万元), 累计折旧(万元), 成新率

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及子公司拥有发明专利 30 项、实用新型专利 12 项, 具体情况如下:

3. 专利
截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及子公司拥有发明专利 30 项、实用新型专利 12 项, 具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及子公司拥有的国内注册商标情况如下:



截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及子公司拥有发明专利 30 项、实用新型专利 12 项, 具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利权人, 专利号, 申请日期, 专利权期限

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及子公司拥有的国内注册商标情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利号, 申请日期, 专利权期限

上述“直拉硅片”的内吸工艺“主要用于在硅片表面处理工序, 一种即刷光

上述“直拉硅片”的内吸工艺“主要用于在硅片表面处理工序, 一种即刷光

2018 年 1 月 10 日, 浙江大学硅材料国家重点实验室与浙江金瑞泓签订

上述专利许可符合国资管理相关规定, 未造成国有资产流失, 不存在纠纷

5. 非专利技术
公司目前拥有的非专利技术主要为公司在生产过程中通过长期的经验积累

此外, 2017 年 7 月 6 日, 立昂微电子与浙江大学签订《技术转让(技术秘

立昂微电子与浙江大学签订《技术转让(技术秘)》, 受让浙江大学拥有的砷化镓(GaAs)

立昂微电子与浙江大学签订《技术转让(技术秘)》, 受让浙江大学拥有的砷化镓(GaAs)